

# 第1回 ダイヤモンドウェハ及び 関連技術セミナー

半導体の基板となり得る実用的なサイズのダイヤモンドウェハ製造の可能性が高まり、産業化へ向けた機運が出始めています。  
本セミナーではダイヤモンドウェハ技術とその応用に関する現状と今後について解説します。

藤森 直治氏

株式会社イーディービー  
代表取締役社長

大島 武氏

量子科学技術研究開発機構  
量子機能創製研究センター長

梅沢 仁

産総研  
先進パワーエレクトロニクス研究センター  
ダイヤモンドデバイス研究チーム  
上級主任研究員

山田 英明

産総研  
先進パワーエレクトロニクス研究センター  
ダイヤモンドウェハ研究チーム  
研究チーム長

2026年3月27日[金] 13:45~16:35 (受付開始13:15)

場 所 グラングリーン大阪 北館6階 JAM BASEカンファレンス6-2

参加費 無料

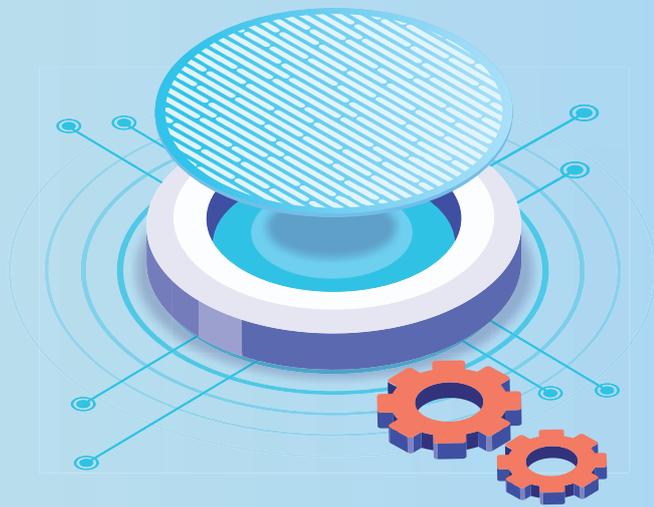
【主催】 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 関西センター

2026 3.27 Fri

13:45~16:35 受付開始 13:15

## グラングリーン大阪 北館6階 JAM BASEカンファレンス6-2

JR大阪駅下車・徒歩7分 (<https://jambase-space.com/access/>)  
※オンサイトのみ開催です(オンライン配信はありません)



### 主催

産業技術総合研究所 関西センター

### 参加費

無料(交流会は会費3,000円)

### 定員

セミナー100名/交流会50名  
(いずれも先着順)

### 申込方法

3月23日(月)17:00締切

右記の申込フォームリンクより  
お申し込みください。

<https://www.aist.go.jp/kansai/ja/event/ef20260327.html>



上記申込フォームが利用できない場合は、参加者の氏名(ふりがな)、所属(役職)、交流会の参加/不参加を下記問合せ先までメールにてお知らせください。

### 問合せ

ダイヤモンドウェハ及び  
関連技術セミナー事務局

電話:072-751-9606

e-mail:M-diamondwaferseminar-ml@aist.go.jp

### プログラム

#### セミナーの部

13:45 開会の辞

安田 和明 産総研 関西センター 所長代理

13:50 本セミナーの趣旨説明

山田 英明 産総研 先進パワーエレクトロニクス研究センター  
ダイヤモンドウェハ研究チーム 研究チーム長

14:10 招待講演

「大型ダイヤモンドウェハ開発の現状と課題」

藤森 直治氏 株式会社イーディーピー 代表取締役社長

14:50 休憩

15:05 講演

「ダイヤモンド半導体の研究開発と応用」

梅沢 仁 産総研 先進パワーエレクトロニクス研究センター  
ダイヤモンドデバイス研究チーム 上級主任研究員

15:45 招待講演

「ダイヤモンドの量子技術への応用の現状と未来」

大島 武氏 量子科学技術研究開発機構 量子機能創製研究センター長

16:25 閉会の辞

山田 英明

16:30 事務連絡

#### 交流会の部

17:00 交流会(産総研・関経連うめきたサイト 交流室)

※会費:3,000円/会場にてお支払いください/適格請求書発行不可

